

## 第3回ソフトマター工学分科会講演会・会員総会

### 主催

化学工学会 材料・界面部会ソフトマター工学分科会

### 協賛

化学工学会材料・界面部会, 分離プロセス部会, 日本化学会, 分離技術会, 日本吸着学会, 日本 MRS 学会, 日本レオロジー学会, 高分子学会, 東京農工大学工学部化学システム工学科

(赤字は昨年の本会の協賛、今年も協賛していただく予定)

### ご案内

公益社団法人 化学工学会材料・界面部会内に「ソフトマター工学分科会」を平成28年3月1日設立しました。本会は、同部会内にあった「高分子・ゲルテクノロジー分科会」と「自己組織化分科会」を発展的に統合し、高分子・ゲル・コロイド・分散系などのソフトマテリアル全般の機能発現や制御およびその製造プロセスを対象として、微細構造, 界面活性剤, コロイド分散系, 秩序化, 核生成, 構造・相分離制御, 成形加工, レオロジー, 刺激応答などを化学工学的に理解し, ハンドリングする技術を構築していくことを目指しています。このたび第3回講演会を企画し, 会員間の学術および人的交流を深めていきたいと考えています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。また, 本分科会の趣旨にご賛同頂ける方々の入会も併せてお待ちしております。

日時 2018年7月27日(金)10:00~17:15(交流会 17:30~19:30)

場所 東京農工大学小金井キャンパス 科学博物館 3階 講堂

〒184-8588 東京都小金井市中町 2-24-16

交通 JR 中央線 東小金井駅 nonowa 口から徒歩 6 分

<http://www.tuat.ac.jp/outline/overview/access/>

### プログラム

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 主催者挨拶                              | (10:00~10:10) |
| 1. 「エレクトロスピンニングによるナノファイバとその複合化」    | (10:10~11:00) |
| 慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻 教授 堀田 篤 氏  |               |
| 2. 「熱可塑性エラストマーの設計と高機能化」            | (11:10~12:00) |
| 三井化学(株)高分子材料研究所ポリマーテクノロジーG 岡本 勝彦 氏 |               |
| 会員総会(会計・活動報告、会員研究紹介)               | (13:10~13:30) |

3. 「磁性ナノ粒子生合成から端緒を得た機能性バイオナノ材料の合成」 (13:30～14:20)  
東京工業大学物質理工学院応用化学系 助教 田中 祐圭 氏
4. 「水溶性増粘剤による化粧品基剤のレオロジーコントロール」 (14:30～15:20)  
資生堂グローバルイノベーションセンター 中村 綾野 氏
5. 「特殊構造を有する高分子半導体の設計と応用」 (15:30～16:20)  
東京農工大学大学院生物システム応用科学府 教授 荻野賢司氏
6. 会員研究紹介(ショートプレゼンテーション) (16:30～17:15)  
交流・名刺交換会 講演会場内にて開催 (17:30～19:30)

### **申込締切**

7月13日(金) ただし、定員(100名)に達し次第締切とさせていただきます。

### **参加費**

分科会個人会員・法人会員(協賛団体含む) 6,000円、会員外 10,000円(学生の場合 2,000円)、なお、法人会員の方は3名まで会員価格で参加できます(4人目以降は個人会員でなければ会員外となります)。また、参加費には昼食代等の飲食費は含まれておりません。交流会にご参加の方は、会員種別に関わらず別途 2,000円が必要となります。

### **申込先・問合せ先**

〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1

岡山大学大学院自然科学研究科応用化学専攻内、化学工学会材料・界面部会ソフトマター工学分科会事務局, TEL/FAX:086-251-8083,

E-mail: [softmatter.eng2016@gmail.com](mailto:softmatter.eng2016@gmail.com), Web: <http://softmatter-eng.net>